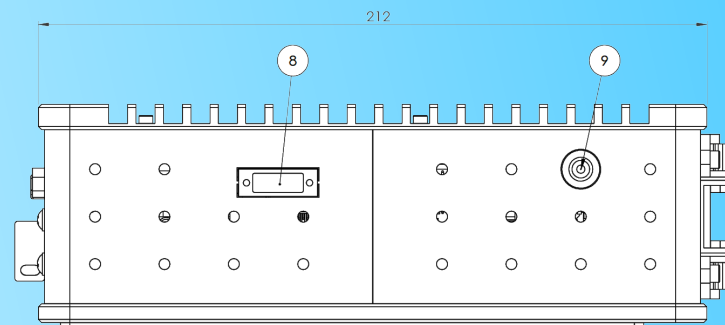
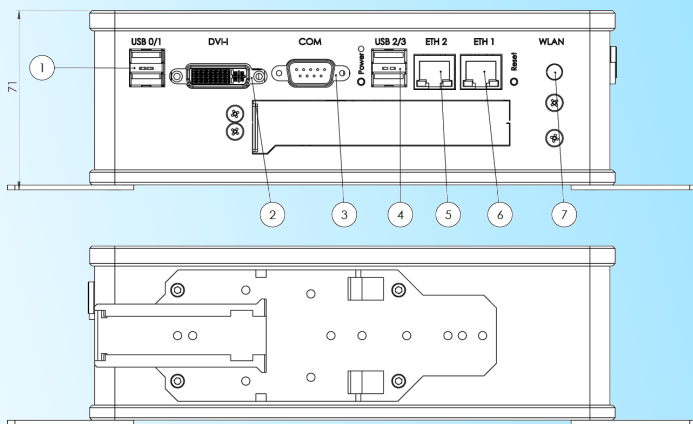
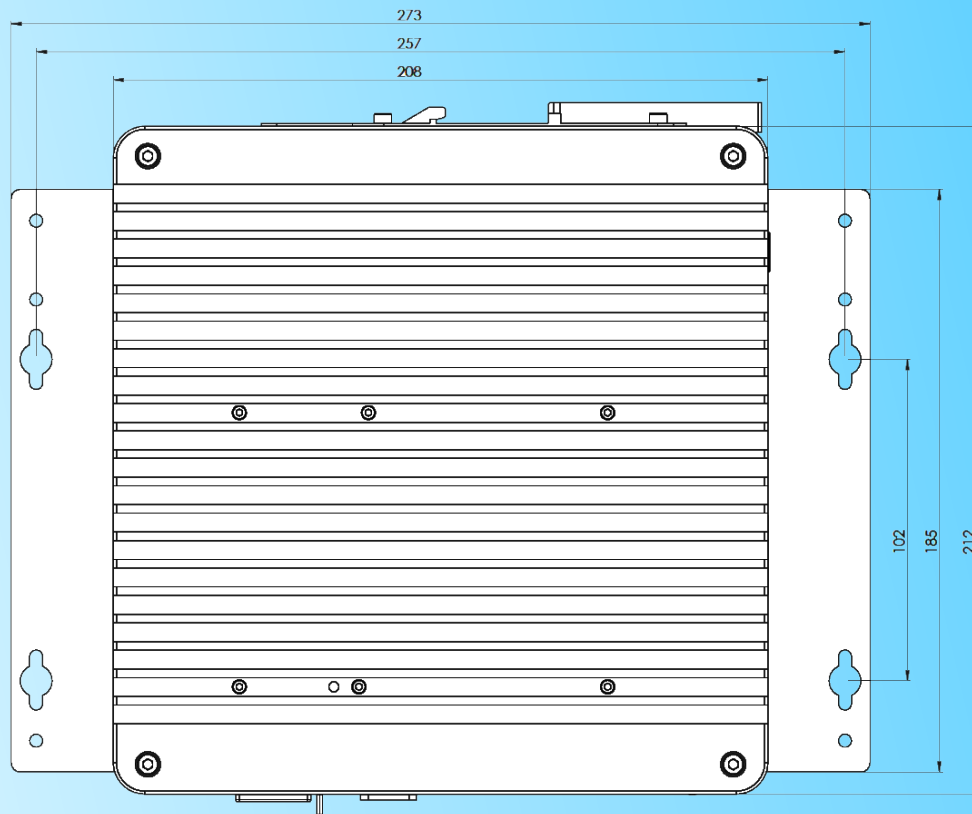


# INNOVO VARIO



# Vermessung



1. USB 2.0
2. DVI-I Anschluss
3. Sub-D9 (male)
4. USB 2.0
5. Gigabit Ethernet RJ-45 mit Boot-On-LAN / IEEE1588
6. Gigabit Ethernet RJ-45 mit Boot-On-LAN / IEEE1588
7. W-LAN (optional)

8. Spannungsversorgung DC 24 Volt (Filter)
9. Spannungsversorgung 12-36Volt DC

# Mögliche Montage

*...durch Hutschienen*



*...oder Halbleche*



## Highlights

- **Robustes hochwertiges Gehäuse aus Aluminium "Made in Germany"**
- **Extrem robuste Gesamtkonstruktion durch direkte Montage / Kopplung**
- **Geschlossene Variante sowie mit Lüftungsschlitzen**
- **Passive optimierte Kühlung**
- **EMV geprüft nach Norm: EN55022:2006+A1:2007 Grenzklasse A (Störaussendung) EN55024:2010 (Störfestigkeit)**
- **Langzeitverfügbarkeit**
- **Hohe Funktionssicherheit und Langlebigkeit (24/7)**
- **Gehäuse optional mit internem Lüfter für kritische Temperaturbereiche**
- **Über Riserkarte flexibel erweiterbar mit PCI/PCIe Karte**
- **Gleichzeitiger Einsatz von 3 verschiedenen Speichermedien möglich (2x2,5" SSD/HDD optional RAID 1), 1 x CompactFlash & 1x CFast Card**
- **Plattform für Industrial Virtualisation mit VMware-vSphere Hypervisor (ESXi)**
- **Sonderkonfigurationen auf Anfrage**

# Spezifikationen

## RS-IPC-VARIO-1



**Gehäuse** INNOVO Vario 1 (Einfache Bauhöhe)

**Farbe** Nach Absprache

**Mainboard** Basebaord for COM Express Modules Type 2

- M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format!]
- 24 Volt DC Anschluss (Phoenix)

**Wichtig:** Vario 1 kein Filter möglich, erst ab Vario 2

## RS-IPC-VARIO-2



**Gehäuse** INNOVO Vario 2 (Zweifache Bauhöhe / 1x Zusatzkarte)

**Farbe** Nach Absprache

**Mainboard** Basebaord for COM Express Modules Type 2

- M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format!]
- 24 Volt DC Anschluss (Phoenix)

## RS-IPC-VARIO-3



**Gehäuse** INNOVO Vario 3 (Dreifache Bauhöhe / 2x Zusatzkarte)

**Farbe** Nach Absprache

**Mainboard** Basebaord for COM Express Modules Type 2

- M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format!]
- 24 Volt DC Anschluss (Phoenix)

# Spezifikationen

## RS-IPC-VARIO-1 / 2 / 3

<b>CFast</b>	1x Steckplatz auf Mainboard Oberseite
<b>CompactFlash</b>	1x Steckplatz auf Mainboard Unterseite
<b>Massenspeicher</b>	1x 2,5“ Harddisk/SSD via SATA (direkt montiert auf Mainboard Unterseite, ohne Kabel)
<b>Filter-Option</b>	für INNOVO Vario 2-3 24 Volt DC Anschluss (Phoenix)  EMV geprüft nach Norm 24Volt Filter: <ul style="list-style-type: none"><li>• EN55022:2006+A1:2007 Grenzkategorie A (Störaussendung)</li><li>• EN55024:2010 (Störfestigkeit)</li></ul>
<b>Schalter-Option</b>	SW-USB-LED Front Option für INNOVO Vario 1-3 <ul style="list-style-type: none"><li>• Einschalter in der Front</li><li>• HDD und Power Led in der Front</li><li>• USB2 Anschluss in der Front</li></ul>
<b>Gigabit Ethernet</b>	2x RJ-45 (mit Boot-On-Lan / IEEE1588)
<b>RS232</b>	1x Sub-D9 (male)
<b>RS485</b>	optional über Adapterplatine an COM der internen Display-Schnittstelle
<b>SATA</b>	1x SATA-Anschluss für zusätzliche/s Harddisk oder DVD-Laufwerk
<b>USB</b>	4x USB 2.0 (extern) 2x USB 2.0 (intern auf Pfostenleiste)
<b>I/O-Schnittstellen</b>	1x IO-Extension Interface mit PCIe, USB, LPC, HD-Audio, SVDO, I2C (für proprietäre Erweiterungskarten)
<b>Modul-Steckplatz</b>	COM Express (Basic & Compact, Typ 2)
<b>Mini PCIe</b>	1x Steckplatz auf Mainboard Unterseite (PCIe & USB)
<b>Schnittstelle für Riser</b>	1x Riser-Interface (für Standard PCI/PCIe Karten, max. 2x PCIe & 4x PCI)
<b>Externe Displayschnittstelle</b>	DVI-I Anschluss (digital & analog) für DVI und/oder VGA Monitor
<b>Interne Displayschnittstelle</b>	Dual Channel LVDS (18/24) + USB & COM für Touch
<b>Batterie</b>	1x CR2032 gesockelt
<b>Buzzer</b>	auf dem Mainboard
<b>Lüfteranschluss</b>	1x 3-pol., 12 V, PWM gesteuert, Tacho-Eingang
<b>Reset-Taster</b>	auf Mainboard + Anschluss über Systemsteckverbinder
<b>Spannungsversorgung</b>	ATX 20-Pin; 12V (+/- 5%), 5V (+/- 5%), 3,3V (+/- 5%), 5V Standby
<b>Status-LED</b>	1x Power-LED und 1x Activity LED (auf Mainboard + Anschluss über Systemsteckverbinder)
<b>Stecksystem</b>	1x Pfostenleiste 10-pol. zur Anbindung von Power-Button, Power-LED, Reset-Button und Activity-LED

# Varianten

## **COMKit-D2550-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG** **Neuste Intel Atom Technologie**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Atom D2550 / NM10 (conga-CCA/D2550)  
(Dual Core, 2x 1.86GHz, 1MB L2 Cache, 10W TDP)
- 2GB DDR3 SO-DIMM
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung

Auch erhältlich: Varianten mit Intel Atom N2600 / N2800

**Hinweis:** Bei diesem Kit sind nur die analogen Ausgangssignale des DVI-I Ports verfügbar.  
Es können keine digitalen DVI Monitore angeschlossen werden

## **COMKit-1047E-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG** **Effiziente und kostenoptimierte Ultra-Low-Power Dual Core Lösung**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Celeron 1047 (conga-BS77/1047)  
(Dual Core, 1.4GHz, 2MB Cache, HD Graphics 3500 HM76)
- 2x 4GB DDR3 SO-DIMM (Max)
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung  
(mit integrierten Heatpipes für optimale Wärmeverteilung)

## **COMKit-i3-3217UE-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG** **Rechenstarke und sparsame Core i3 Dual Core Lösung** **(3. Generation Core Technologie „Ivy Bridge“)**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Core i3-3217UE (conga-BS77/i3-3217UE)  
(Dual Core, 1.6GHz, Hyperthreading, 3MB cache,  
HD Graphics 4000, 17W TDP), QM77 Chipsatz
- 2x 2GB DDR3 SO-DIMM
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung  
(mit integrierten Heatpipes für optimale Wärmeverteilung)

## **COMKit-i7-3517UE-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG** **Höchste Rechenleistung mit sparsamen i7 Dual Core** **(3. Generation Intel Core Technologie „Ivy Bridge“)**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Core i7-3517UE  
(Dual Core, 1.7GHz, TurboBoost bis max. 2.8GHz, Hyperthreading,  
4MB cache, HD Graphics 4000, 17W TDP) QM77 Chipsatz
- 2x 4GB DDR3 SO-DIMM
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung  
(mit integrierten Heatpipes für optimale Wärmeverteilung)

# Optionen

**RS-IPC-IAP-HB** Haltebleche Rechts und Links

**RS-Set-HDD-KT-SSD64** SANDISK X110 64GB SSD SATA3 6,35cm 2.5Zoll Industrie  
+  
Mounting Set für eine direkte Montage einer 2,5“ HDD/SSD im unteren Bereich des Mainboards MB-COME-(-T)

**RS-Set-HDD-KT-SSD128** SANDISK X110 128GB SSD SATA3 6,35cm 2.5Zoll Industrie  
+  
Mounting Set für eine direkte Montage einer 2,5“ HDD/SSD im unteren Bereich des Mainboards MB-COME-(-T)

**RS-Set-HDD-KT-SSD256** SANDISK X110 256GB SD6SB2M-256G SSD X210 6,35cm 2,5Zoll  
7mm  
+  
Mounting Set für eine direkte Montage einer 2,5“ HDD/SSD im unteren Bereich des Mainboards MB-COME-(-T)

**RS-RISER-COME- PCI** Riser Adapter für eine PCI Standard-Karte am Mainboard

**RS-RISER-COME-PCIE** Riser Adapter für eine PCIe x1 Standard-Karte am Mainboard

**RS-Set-HDD-KT** Montageset für direktes Montieren einer 2,5“ HDD/SSD am Mainboard MB-COME-1L(-T)

# Entsorgung

**Das Gerät kann beim Hersteller kostenlos entsorgt werden:**

R&S Informations- und Computersysteme GmbH  
Riedstraße 2  
D 53859 Niederkassel

**e-mail: [info@rscomputer.net](mailto:info@rscomputer.net)**